

Technische Daten Kupfer und niedrig legiertes Kupfer ¹⁾

		Kupfer	sauerstofffreies Kupfer		niedrig legiertes Kupfer		
		Cu-ETP1	Cu-OF1	Cu-OF1 selekt. *)	CuAg0,1 *)	HCHS **)	
Werkstoff - Nr.	DIN / EN	CW003A	CW007A	-	CW013A	-	
	UNS	C11040	C10100	-	C11600	-	
Legierungsbestandteile	[%]	≥ 99,95 Cu	≥ 99,99 Cu	≥ 99,99 Cu Incl. Ag	≥ 99,80 Cu Ag 0,1	≥ 99,60 Cu	
spezifische elektrische Leitfähigkeit ²⁾	[m/(Ohm mm ²)]	58	58	58	57	50	
spezifische elektrische Leitfähigkeit ²⁾	[% IACS]	100	100	100	98	86	
Wärmeleitfähigkeit ²⁾	[W/(m K)]	390	390	390	390	355	
Wärmeausdehnungskoeffizient ³⁾	[10 ⁻⁶ / K]	17	17	17	17	17	
Zugfestigkeit weich	[N/mm ²]	240	240	240	240	-	
Bruchdehnung weich	[%]	30	30	30	30	-	
Zugfestigkeit hart	[N/mm ²]	450	450	450	450	600	
spezifisches Gewicht	[g/cm ³]	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	

- 1) Richtwerte für Draht 0,8 mm
 2) bei 20° C
 3) Temperaturbereich 20 - 200° C

- *) erhöhte Wärmebeständigkeit
) exzellente Wärmebeständigkeit bis 600° C (H**igh **C**onductivity **H**igh **S**trength)